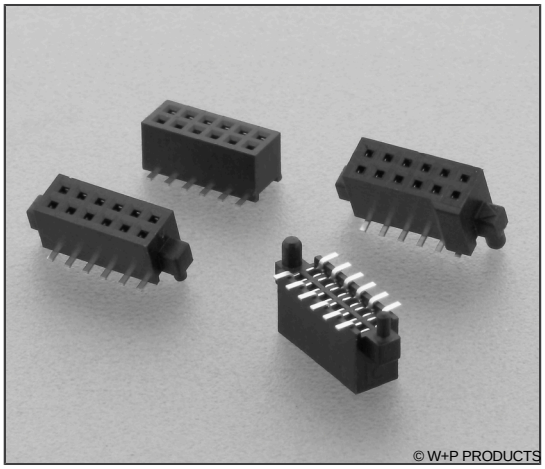
6060

SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 3,6/4,5mm, durchsteckbar

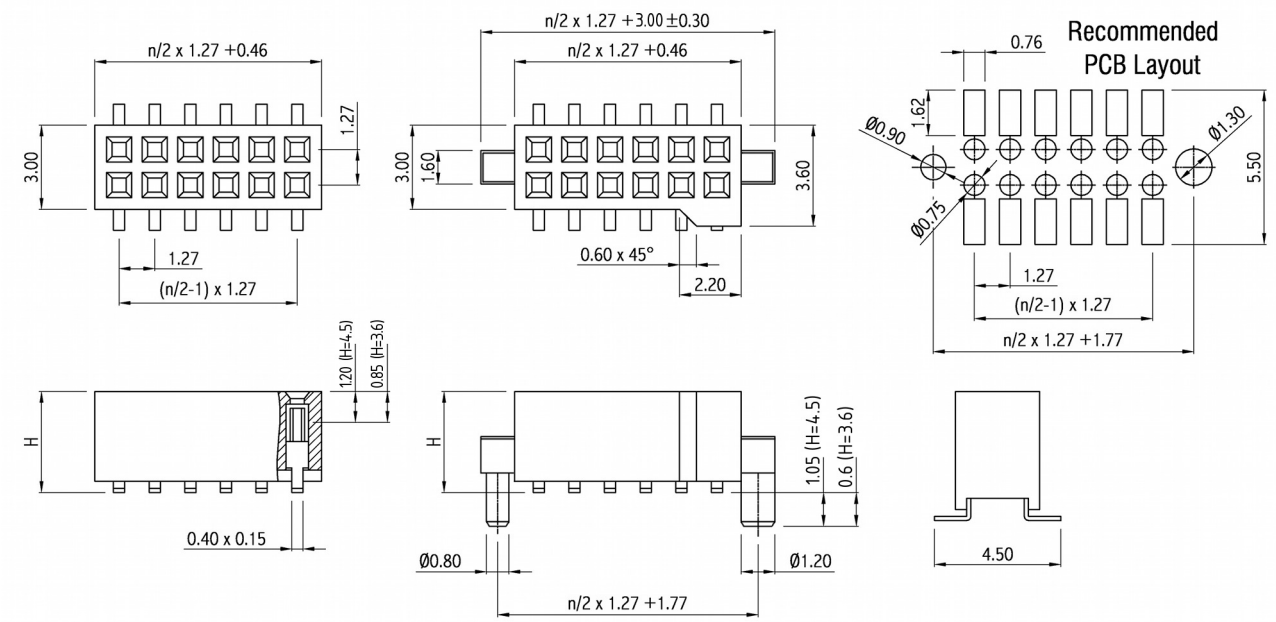
SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 3.6/4.5mm Profile, Pass Through

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	*500 V AC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	*Reflow soldering*



Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,40mm.
Dual beam contacts accept 0.40mm square pins.
Passende Wannenstiftleisten:
Compatible Box Headers:
6110 6111



Series	*Contacts**	*Profile**	*Plating**	*Locating Pegs**	*Polarisation Key**	*Packaging**
6060 –	**040** ———	**46** ———	**00** ———	**10** ———	**10** ———	**PPST**
	006-080 Zweireihig *Double row*	**36** Bauhöhe 3,60mm *Height 3.60mm* **46** Bauhöhe 4,50mm *Height 4.50mm*	**00** Vergoldet *Gold plated* **50** Verzinnt *Tin plated*	**00** Ohne Pos.hilfen *W/o loc. pegs* **10** Mit Pos.hilfen *With loc. pegs*	**00** Ohne Verpolschutz *W/o pol. key* **10** Mit Verpolschutz *With pol. key*	**ST** **PPST** **PPTR**

Lieferformen / *Packaging Options:*
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
PPST In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

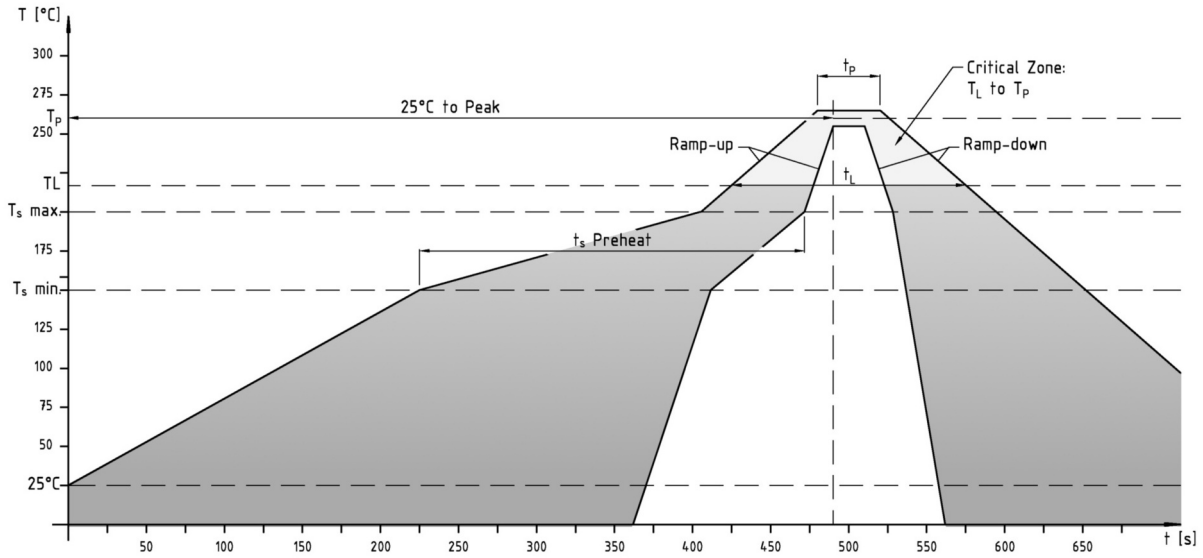
Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*